

证券代码：300782

证券简称：卓胜微



江苏卓胜微电子股份有限公司
2025年度向特定对象发行A股股票
募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年一月

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过350,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
1	射频芯片制造扩产项目	418,243.26	300,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		468,243.26	350,000.00

除补充流动资金项目外，本次募集资金将全部用于射频芯片制造扩产项目的资本性支出部分，其余部分由公司通过自有或自筹资金解决。

本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金补足。

二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况

本次发行募集资金总额扣除发行费用后将用于射频芯片制造扩产项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目具体情况如下：

（一）射频芯片制造扩产项目

1、项目基本情况

项目名称	射频芯片制造扩产项目
实施主体	无锡芯卓湖光半导体有限公司
项目总投资金额（万元）	418,243.26
拟使用募集资金（万元）	300,000.00
项目建设期	4年
项目建设内容	扩建射频芯片生产线
项目建设地点	江苏省无锡市胡埭工业区钱胡路以北、刘闾路以东、洋溪河以南地块

2、项目建设的必要性

(1) 公司增量需求广阔，既存需求旺盛，亟需项目扩产

根据QY Research统计，2024年全球射频前端模组市场约为265.40亿美元，未来有望继续增长。一方面当前5G技术核心射频前端芯片及模组生产的国产替代需求迫切，产能需求有望不断增加；另一方面公司通过持续依托自有产线深耕技术工艺研发，发挥快速产品迭代优势，推出更加定制化及模组化的新产品，可触达更加高端化、定制化的客户需求与更丰富的应用场景，从而进一步扩大与主要客户的合作，获取更多市场份额。

同时，公司既存市场产品也体现了旺盛的需求，当前公司自建产线已部分满足了既存产品需求，为了进一步稳定既存产品市场的供给，排除各种外部不利因素的干扰，公司亟需进行项目扩产。

本项目的实施可以保障公司在进一步稳固现有供应链的基础上，更好地满足不断增长的市场需求。

(2) 实现工艺技术平台演进，高效满足客户高端定制化产品生产需求

射频前端芯片的主要应用领域为以智能手机为主的移动终端设备。随着通信技术的不断发展，移动终端设备需要支持的通信频段增多，射频前端芯片需集成的器件数量显著提升，且消费者对移动终端设备的需求呈现出轻量化的趋势，使得射频前端芯片逐渐向模块化、集成化的方向演进。同时，为了满足消费端对移动终端设备的多元化需求，终端设备厂商开发了多样化的产品，从而对射频前端芯片的性能、成本等产生了差异化诉求，促使射频前端芯片向差异化、定制化的方向发展。

受益于公司自主产线定制化产品的量产优势，公司射频前端模组收入比例逐年增长，2024年1-6月，公司射频前端模组收入占营业收入的比例已超过40%；预计未来几年，公司射频模组产品收入占比还将持续上升，随着更加定制化的发射端模组产品的陆续推出，公司的生产制造能力亟需通过本项目迈上新台阶。

高度定制化的射频模组一方面研发投入大、研发周期长，技术突破点众多，要求公司不断推陈出新，深刻理解器件工艺架构并通过设计研发与制造工艺的密切联动来支撑定制化射频模组的快速更新迭代；另一方面，当前晶圆代工厂通用型工艺无法最

大化满足客户差异化与定制化需求。终端客户的多元化需求使得公司可能需要为一颗产品定制一套设计方案和一套工艺架构或需要为同一系列产品定制不同的工艺实现方案，而晶圆代工厂的商业模式追求在通用工艺平台上持续形成产出，其进行高度定制化的工艺迭代并满足终端客户的差异化与定制化需求的风险较高、周期较长。

本次募集资金投资项目实施后，公司将扩充高端射频前端芯片制造产能。在工艺技术方面，公司能够更深入地掌握核心技术和生产工艺，更高效地响应市场需求和技术变化，加速产品的迭代升级，亦可突破标准化制造工艺的局限，将晶圆制造与晶圆级先进封装有机结合，在成本、性能和效率等方面有所提升；在产品方面，公司生产环节得以充分匹配公司设计需求实现专属设计的定制化工艺，从而进一步提升产品的市场竞争力，实现公司模组化、定制化的产品布局。

（3）保障公司供应链安全，强化我国射频前端芯片产业自主可控能力

当前，全球地缘政治摩擦加剧、供应链限制层出不穷给我国射频产业链带来了诸多不稳定因素。本项目实施后，公司的供应链重心将进一步向国内迁移，通过自有产线扩建不仅可以更好地满足客户需求，而且进一步提高了公司自身供应链的安全性、可靠性，为公司日常经营与长期发展提供了更加稳定的支持。

公司所处的射频前端芯片行业在国家战略和通信安全中占据重要地位。公司重点布局的射频前端芯片及模组产品是集成电路产业中的核心领域，是通信技术代际更替的关键驱动，是中国攻克集成电路“卡脖子”问题并实现在产业链高端领域快速布局的重要突破口。长期以来，高端射频前端芯片及模组的设计及生产能力被国际领先射频企业控制，虽然近年来我国射频前端芯片行业实现了快速发展，技术水平和产业规模均有大幅提升，但在高端射频前端芯片及模组的设计及生产能力上仍缺少足够的技术积累，与国际领先技术相比仍存在一定差距。

本项目的实施一方面深化了公司对于射频产业链关键环节和重点领域核心技术制造的突破和掌握，进一步提高公司射频工艺制造能力，提高产品竞争力；另一方面，也强化了自主可控的射频前端芯片和模组的全产业链生态，为国家信息产业的安全提供了进一步保障。

（4）保障公司核心知识产权信息安全，进一步巩固技术壁垒

射频前端模块化和差异化的发展趋势使得在更小的尺寸上集成更多射频器件、以

更合理的成本实现更优的效能成为射频前端行业明确的演进需求，也正驱动了射频前端特色工艺的迅速发展。

为了满足客户对于射频前端模组的个性化需求，公司存在个性化定制设计方案及特色工艺实现路径的情形，从而在开发过程中形成了大量的差异化解决方案。在Fabless模式下，公司产品的交付过程被切分成了设计与生产两个相对独立的部分，由公司与代工厂分别完成。生产过程中晶圆代工厂需要根据设计端的需求修改其产品设计包中的设计规则、模型和IP等。虽然行业内对此已形成了较为完善的权责划分，但公司无法对晶圆代工厂端的技术独立申请专利保护。若设计与生产两个环节均由公司完成，公司可将设计端与工艺端紧密配合的特色工艺方案独立申请专利，在高度定制化需求和特色工艺开发方面逐步构建起自身的专利壁垒，从而更好保护公司的知识产权与商业机密。

本次项目的实施可以充分保护公司特定设计需求联动产生的关于工艺、器件、设备甚至零部件等的专利，进一步巩固公司的技术壁垒。

3、项目建设的可行性

(1) 国家法律法规及发展规划为本项目提供了良好的政策环境

集成电路作为信息产业的基础和核心组成部分，是关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业。近年来，针对集成电路行业的法律法规和产业政策密集发布，推动了行业的快速发展。

2023年4月，财政部税务总局发布了《关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，降低了集成电路企业的经营成本，为集成电路企业的高质量发展提供了机会。

2023年8月，工信部发布了《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》，明确“集成电路、新型显示、服务器、光伏等领域”是提升产业链现代化水平的重点领域，对“充分调动各类基金和社会资本积极性，进一步拓展有效投资空间，有序推动集成电路、新型显示、通讯设备、智能硬件、锂离子电池等重点领域重大项目开工建设”表达了支持的态度。

2020年，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，在财税、投融资、研究开发、进出口、知识产权、人才等方面制定了若干政策，优化集成电路产业和软件产业发展环境，引领了集成电路产业提高创新能力和高质量发展的方向。

本项目的建设是对国家支持集成电路产业发展的积极响应，是保障国家集成电路产业链安全与在射频前端芯片高端市场抢占主导地位的战略选择，国家产业政策及发展规划对于集成电路行业的支持与引领为本项目的实施奠定了良好的政策基础。

(2) 射频前端市场空间广阔、公司客户资源稳定、下游应用场景不断拓展

1) 射频前端市场空间广阔

广阔的手机市场以及新技术、新应用的涌现为射频前端市场提供了稳定的市场基础，具体分析详见本预案之“第一节 本次向特定对象发行股票概要”之“二 本次向特定对象发行股票的背景和目的”之“（一）本次向特定对象发行股票的背景”之“射频前端产业具有稳定且规模庞大的市场基础”。

2) 公司客户资源稳定

凭借研发能力、供应链管理等优势，公司与国内外具有市场影响力的终端客户均形成了稳定的客户关系。公司在上海、深圳、成都、重庆、美国、韩国、日本均设有研发或销售中心，形成高效的业务协同网络；同时依靠研发优势和质量优势在国内外积累了丰富的客户资源，建立了完善的客户支持体系，为长期稳定的合作关系提供了有力保障。

3) 进一步拓展下游应用场景

在消费端需求稳步增长的同时，公司持续拓展应用场景，基于消费端稳定的客户基础，积极寻求在5G通信基站及汽车电子等应用场景与国内外主要终端厂商的合作机会。

随着通信技术的不断演进，通信基站对射频前端器件的需求也有所增加。一方面，5G网络建设稳步推进，根据工信部数据，截至2024年11月末，5G基站总数达419.1万个，比上年末净增81.5万个，占移动基站总数的33.2%，占比较上年末提高4.1%；另一方面，随着5G走向5.5G甚至提前布局的6G，基站软硬件设备不断更新，5.5G需要10倍

于5G的传输速率，对于射频前端芯片及模组的性能和复杂度具有更高的要求。

随着辅助驾驶以及自动驾驶的兴起，汽车对周围环境感知能力要求越来越高。与此同时，由于需要进行实时的信号处理和决策，感知能力以外的快速数据处理与分析决策能力也成为自动驾驶中至关重要的环节。为了实现汽车的智能化感知与决策，需要采用汽车雷达模组提供长程和中程的环境探测感知，这也促进了射频芯片需求的快速增长。

5G通信基站射频器件及汽车电子应用场景的主要终端客户与公司现有客户存在一定重合。本项目建成后，公司不仅可利用现有的客户基础，深化和拓展新领域的合作机会，还可基于长期的技术与工艺积累，通过积极拓展通信基站及汽车电子等领域销售渠道和客户版图，进一步积累能够长期合作的稳定的客户资源。

（3）公司具有成熟的工厂运营经验、技术基础扎实、人才储备丰富

公司已初步实现由Fabless模式向Fab-Lite模式的转型，形成了从研发设计、晶圆制造、封装测试到销售的完整产业生态链。在转型的过程中，公司通过自有产线的搭建已经积累了较为成熟的产线建设、产能爬坡、产线运营与管理等方面的能力。

技术方面，公司已自主培养了成熟的射频器件及模组研发设计和运营管理团队，研发团队核心成员拥有多年射频器件设计、开发、性能调试，以及丰富的射频器件及模组的封装技术研发经验。当前公司自有产线已经完成多种产品量产或出货，形成了对多种射频前端工艺的深厚积累。

人才储备方面，经过多年在射频前端应用领域的深耕与积累，公司已建立了一支稳定高效、自主创新、拥有成熟完善管理体系的专业团队，涵盖了技术研发、市场营销、生产运营、品质管理、财务管理、制造工艺等各部门。公司的主要技术人员均于国内外一流大学或研究所取得高等教育学位，并曾任职于国内外知名芯片厂商，具备优秀的技术能力和丰富的产品开发经验。

因此，公司在工厂管理经验、技术储备、人力资源等方面的积累为本项目的实施提供了全方位保障和支持。

（4）项目具备良好的经济效益

本项目具备较好的经济效益。本项目的实施提升了公司的生产能力与技术水平，

有利于增强公司的盈利能力。

4、项目投资计划

本项目总投资为418,243.26万元，用于扩建射频芯片制造产线，生产高端射频器件及模组产品。本项目拟使用募集资金300,000.00万元。具体情况如下：

射频芯片制造扩产项目				
序号	名称	总投资金额（万元）	募集资金投入金额（万元）	募集资金投入占比
1	硬件设备费	351,400.00	300,000.00	85.37%
2	研发费用	30,000.00	-	-
3	基本预备费	18,122.38	-	-
4	利息费用	16,280.88	-	-
5	其他建设费用	2,440.00	-	-
投资总额		418,243.26	300,000.00	71.73%

5、项目实施主体

本项目实施主体为无锡芯卓湖光半导体有限公司，为上市公司的全资子公司。

6、项目备案情况

截至本预案公告之日，本项目备案手续尚在进行中。

（二）补充流动资金

1、项目基本情况

经综合考虑行业发展趋势、公司自身实际情况、财务状况及业务发展规划等因素，公司拟使用5亿元募集资金用于补充流动资金。

2、项目建设的必要性

（1）增强公司资金实力，满足公司运营资金需求

在射频前端芯片近年来竞争激烈的背景下，为保持和发展竞争优势，公司近年来持续加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日常营运资金需求亦不断增加。公司拟使用5亿元募集资金用于补充流动资金，从而提升公司资金实力，满足公司的日常运营资金要求。

（2）提高公司抗风险能力

公司面临宏观经济波动的风险、市场竞争风险等各项风险因素。当风险给公司生产经营带来不利影响时，保持一定水平的流动资金可以提高公司抗风险能力。而在市场环境较为有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。通过本次向特定对象发行股票补充流动资金，公司资本结构将进一步优化，降低财务风险和经营压力，提高公司的抗风险能力，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

3、项目建设的可行性

(1) 符合法律法规的规定及公司经营发展战略

公司本次向特定对象发行股票补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的相关规定，具有实施的可行性。本次募集资金到位后，将为公司提供较为充足的营运资金，满足公司经营的资金需求，有利于公司经济效益的持续提升和可持续发展。

(2) 公司具备规范的治理结构和有效的内部控制

公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度，并通过不断改进和完善，形成了较为规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。在募集资金管理方面，公司按照监管要求建立了《江苏卓胜微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和管理等进行了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储及使用，以规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

三、本次发行募集资金对公司的影响分析

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金将用于射频芯片制造扩产项目及补充流动资金，符合国家产业政策及公司发展战略，与公司主营业务密切相关，具有良好的发展前景和经济效益。

本次募投项目的实施将对公司的经营能力、业务发展产生积极影响，有利于保障公司供应链安全、进一步建设自主可控的射频芯片产业链、巩固及提高公司在射频前端领域的抗风险能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的领先地位，符合公司及公司全体股东的利益。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将相应增加，现金流压力将得到缓解，资本结构将进一步改善，公司的资金实力、抗风险能力和后续融资能力将得到提升。

由于本次募投项目有一定建设周期，经济效益的完全实现需要一段时间，因此建设期之初公司净资产收益率、每股收益等财务指标可能有所降低；但长期看来，随着募投项目逐步建成和产能逐渐释放，公司盈利能力将会进一步增强。

四、结论

综上所述，公司本次向特定对象发行A股股票是公司基于自身在市场地位、技术储备、人力资源等方面长期积累的优势，抓住市场发展机遇的选择，符合公司及公司全体股东的利益。本次向特定对象发行A股股票的募集资金投向符合国家发展战略以及市场发展趋势，有利于保障公司供应链安全，进一步提高公司的工艺技术能力，保护公司核心知识产权信息安全，增强公司核心竞争力，使公司在日益激烈的市场竞争中始终处于优势地位。因此，本次公司向特定对象发行A股股票募集资金使用具有必要性、可行性。

江苏卓胜微电子股份有限公司董事会

2025年1月24日